### IEC 62047-9 (First edition – 2011)

Semiconductor devices – Micro-electromechanical devices –

Part 9: Wafer to wafer bonding strength measurement for MEMS

### CEI 62047-9 (Première édition – 2011)

Dispositifs à semiconducteurs -

Dispositifs microélectromécaniques -

Partie 9: Mesure de la résistance de collage de deux plaquettes pour les MEMS

# **CORRIGENDUM 1**

### 3.3.1 General

Replace "as shown in Annex B" by "as shown in Annex A."

# Figure 2

Replace the word "clacking" by "cracking" and the word "clacked" by "cracked" in the Key to this figure.

### 3.4.1 General

Renumber Equation (3) to Equation (2).

Renumber the existing Equations (4) to (7) of the publication accordingly.

# 3.4.3 Procedure

Replace "Equation (3)" by "Equation (2)" in item e) of this subclause.

### 3.4.4 Expression of results

Replace "Equation (3)" by "Equation (2)".

Replace "Equation (4)" by "Equation (3)".

Replace "Equation (5)" by "Equation (4)".

### 3.7.1 General

Replace "Equation (6)" by "Equation (5)" in the first paragraph.

### 3.3.1 Généralités

Remplacer "comme cela est représenté à l'Annexe B" par "comme cela est représenté à l'Annexe A".

### Figure 2

Cette correction ne concerne que le texte anglais

# 3.4.1 Généralités

Renuméroter l'Equation (3) Equation (2).

Renuméroter les Equations (4) à (7) existantes de cette publication en conséquence.

### 3.4.3 Procédure

Remplacer "l'équation (3)" par "l'Équation (2)" au point e) de ce paragraphe.

# 3.4.4 Expression des résultats

Remplacer "l'Équation (3)" par "l'Équation (2)".

Remplacer "l'Équation (4)" par "l'Équation (3)".

Remplacer "l'Équation (5)" par "l'Équation (4)".

### 3.7.1 Généralités

Remplacer "l'Équation (6)" par "l'Équation (5)" au premier alinéa.

March 2012 Mars 2012